

## ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

半導体チップと、この半導体チップの一方表面側に接合され、半導体チップと電気接続された配線基板と、半導体チップの他方表面側に接合され、配線基板と同じ材料からなる反り防止基板とを備えた半導体装置。配線基板の半導体チップとは反対側の表面に、表面実装用の外部接続部材が配置されている。いてもよい。